

东方证券承销保荐有限公司

关于烟台德邦科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”或“保荐机构”或“本保荐机构”)作为正在履行烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“德邦科技”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导工作的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,对德邦科技2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1527号),烟台德邦科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,556.00万股,每股发行价格46.12元,募集资金总额为164,002.72万元,扣除不含税发行费用152,543,951.12元后,公司本次募集资金净额为1,487,483,248.88元。

募集资金总额扣除承销及保荐费(含税)人民币135,894,306.56元后的募集资金为人民币1,504,132,893.44元,已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2022年9月14日汇入公司在招商银行股份有限公司烟台分行开立的账号为535902385410508的人民币账户内,并经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具永证验字(2022)第210029号《验资报告》予以验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:

项目	金额(元)
募集资金到账验资金额	1,504,132,893.44
减:置换以自筹资金预先支付的发行费用	7,283,018.76

项目	金额（元）
支付发行费用	9,366,625.80
募集资金净额	1,487,483,248.88
减：募投项目投入	416,047,049.64
超募部分永久补充流动资金	406,000,000.00
加：扣除手续费后利息收入和理财收益	20,546,221.42
使用闲置募集资金购买大额存单或理财产品净额	546,740,000.00
截止2023年12月31日募集资金专户余额	139,242,420.66

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据有关法律法规及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理制度，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行中国光大银行烟台经济技术开发区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台自贸区支行、华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行、招商银行股份有限公司吴江支行、招商银行股份有限公司烟台分行以及保荐机构东方证券承销保荐有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司与招商银行苏州分行运营中心以及保荐机构东方证券承销保荐有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2023年12月31日，公司均严格按照该前述监管协议的规定，存放与使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金存储情况如下：

开户银行	账号	募集资金余额 (元)
招商银行股份有限公司吴江支行	535902385410968	5,713.79
招商银行股份有限公司吴江支行	535902385410266	35,452,204.42
招商银行股份有限公司烟台分行	535902385410906	534,969.67
招商银行股份有限公司烟台分行	535902385410508	380,667.57
招商银行股份有限公司昆山支行	512910748910966	2,396,200.56
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	1265600000901666	59,452.15
兴业银行股份有限公司烟台分行	378010100100862080	1,066,978.26
中国光大银行烟台经济技术开发区支行	38080188000258467	7,373,430.37
中信银行股份有限公司烟台自贸区支行	8110601011601495861	46,781.89
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	1265600000931613	248,852.14
招商银行股份有限公司烟台分行	535902385410616	91,092,838.07
中国光大银行股份有限公司烟台九隆支行	38090188000191019	584,331.49
招商银行股份有限公司烟台分行	535904836910706	0.28
合计	/	139,242,420.66

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币82,204.70万元，具体情况详见附表1：2023年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023年度，公司不存在以募集资金置换募投项目先前投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年9月28日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币90,000.00万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下用于投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：元

机构名称	产品名称	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率	收益
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	大额存单	144,790,000.00	2022/10/21	2025/10/21	3.20%	固定收益
兴业银行股份有限公司烟台分行	大额存单	20,000,000.00	2022/10/27	2025/10/27	3.20%	
	大额存单	50,000,000.00	2022/11/3	2025/11/3	3.20%	
招商银行股份有限公司吴江支行	点金系列看跌三层区间92天结构性存款	31,000,000.00	2023/10/17	2024/1/17	1.48%-3.20%	保本浮动收益
招商银行股份有限公司吴江支行	点金系列看跌三层区间92天结构性存款	2,000,000.00	2023/11/21	2024/2/21	1.48%-3.10%	
		26,000,000.00	2023/11/21	2024/2/21	1.48%-3.10%	
招商银行股份有限公司吴江支行	点金系列看涨三层区间91天结构性存款	29,430,000.00	2023/12/26	2024/3/26	1.48%-3.05%	
		14,520,000.00	2023/12/26	2024/3/26	1.48%-3.05%	
兴业银行股份有限公司烟台分行	企业金融人民币结构性存款产品（开放式）	29,000,000.00	2023/12/29	2024/3/28	1.50%-2.70%	
招商银行股份有限公司烟台分行	点金系列看跌三层区间31天结构性存款	200,000,000.00	2023/12/29	2024/1/29	1.85%-3.20%	
合计	/	546,740,000.00	/	/	/	/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司于2023年10月18日召开公司2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，

公司拟使用超募资金25,300万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，占超募资金总额的29.99%，公司最近12个月内累计使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

报告期内，公司已从超募资金账户转出15,300万元用于永久补充流动资金。

（六）用超募资金投资建设新项目的情况

本公司于2023年2月15日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》，同意公司使用人民币30,776.20万元超募资金投资设立全资子公司四川德邦新材料有限公司，由该公司作为实施主体开展“新能源及电子信息封装材料建设项目”。

（七）节余募集资金使用情况

2023年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023年度，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《2023年度变更募集资金投资项目情况表》。

（一）“年产35吨半导体电子封装材料建设项目”实施主体、实施地点、拟投入募集资金变更

2023年4月14日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，将“年产35吨半导体电子封装材料建设项目”实施主体、实施地点、拟投入募集资金做了如下调整变更：

项目名称	变更事项	变更前	变更后
	实施主体	德邦（苏州）半导体材料有限公司	四川德邦新材料有限公司

年产35吨半导体电子封装材料建设项目	实施地点	苏州市吴江区汾湖高新区黎里镇318国道北侧	四川彭山经济开发区产业大道12号
	拟投入募集资金(万元)	11,166.48	6,241.99

“年产35吨半导体电子封装材料建设项目”调减募集资金拟投资金额4,924.49万元，其中 3,211.62万元拟用于新建研发中心建设项目的追加投资，剩余部分1,712.87万元及相关利息及理财收益继续留存于募集资金专户，用于新的投资项目。

(二) “新建研发中心建设项目”实施主体、实施地点、拟投入募集资金变更

2023年4月14日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，将“新建研发中心建设项目”实施主体、实施地点、拟投入募集资金做了如下调整变更：

项目名称	变更项	变更前	变更后
新建研发中心建设项目	实施主体	德邦（苏州）半导体材料有限公司	德邦（昆山）材料有限公司
	实施地点	苏州市吴江区汾湖高新区黎里镇318国道北侧	昆山市千灯镇朱家山路西
	拟投入募集资金(万元)	14,479.23	17,690.85

五、募集资金使用披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

德邦科技2023年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及

时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：2023年度募集资金使用情况对照表

附表2：2023年度变更募集资金投资项目情况表

(本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于烟台德邦科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

王国胜

王国胜

李天雄

李天雄

东方证券承销保荐有限公司



2024年4月19日

附表1:

2023年度募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

募集资金净额		148,748.32		本年度投入募集资金总额		25,111.52				
报告期内变更用途的募集资金总额		1,712.87		已累计投入募集资金总额		82,204.70				
累计变更用途的募集资金总额		1,712.87								
累计变更用途的募集资金总额比例		1.15%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高端电子专用材料生产项目 ^(注1)	否	38,733.48	38,733.48	5,980.03	37,773.21	97.52	2023年12月	31,322.94	不适用	否
年产35吨半导体电子封装材料建设项目	是	11,166.48	6,241.99	5.00	5.00	0.08	2024年9月	不适用	不适用	否
新建研发中心建设项目	是	14,479.23	17,690.85	1,681.68	1,681.68	9.51	2024年9月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	64,379.19	62,666.32	7,666.71	39,459.89	62.97	-	-	-	-
超募资金投向										
超募资金永久补流	否		50,600.00	15,300.00	40,600.00	80.24	不适用	不适用	不适用	否
新能源及电子信息封装材料建设项目	否		30,776.20	2,144.82	2,144.82	6.97	2025年2月	不适用	不适用	否
超募资金未用部分	否		4,705.80	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	-		86,082.00	17,444.82	42,744.82	49.66	-	-	-	-
合计	-	64,379.19	148,748.32	25,111.52	82,204.70	55.26	-	-	-	-
项目可行性发生重大变化的情况说明						无				
募集资金投资项目实施地点变更情况						详见本核查意见四、(一)(二)				
募集资金投资项目实施方式调整情况						详见本核查意见四、(一)(二)				
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本核查意见三、(二)				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						无				

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本核查意见三、（四）
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本核查意见三、（五）（六）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：截至2023年12月31日，高端电子专用材料生产项目已整体完工，其中项目一期已于2022年8月达到预定可使用状态，二期已于2024年1月完成消防验收，达到预定可使用状态；注2：高端电子专用材料生产项目本年度实现的效益为所产产品实现对外销售的收入金额；注3：超募资金金额增加1,712.87万元为本报告期内变更募集资金投资项目资金情况的剩余部分。

附表2:

2023年度变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目	年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目	6,241.99	6,241.99	5.00	5.00	0.08	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
新建研发中心建设项目	新建研发中心建设项目	17,690.85	17,690.85	1,681.68	1,681.68	9.51	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
合计		23,932.84	23,932.84	1,686.68	1,686.68	7.05				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目	详见本核查意见四、(一)								
	新建研发中心建设项目	详见本核查意见四、(二)								
未达到计划进度的情况和原因		不适用								